

事業別レビューと今後の見通し

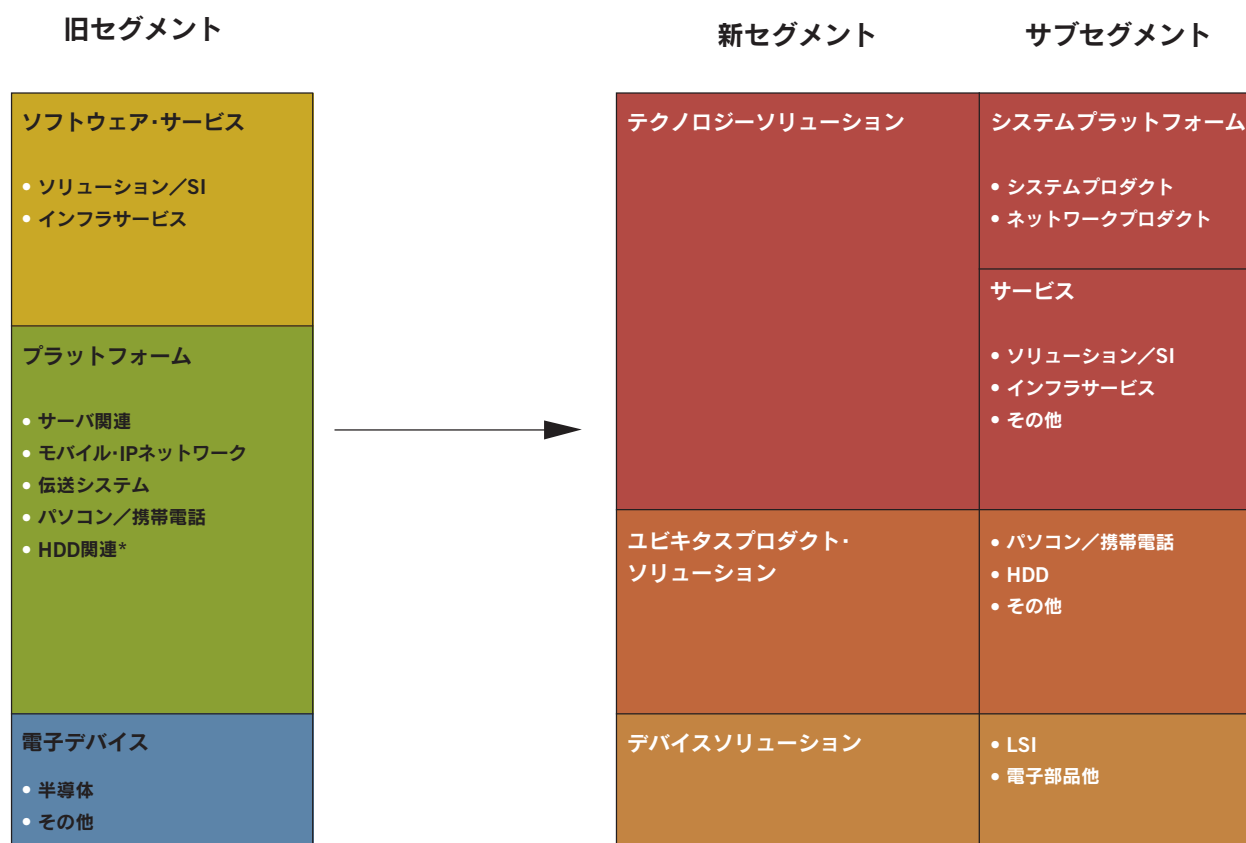
セグメント区分の変更

富士通グループは、世界最先端のテクノロジーを追求するハードウェアとソフトウェア・サービスを組み合わせ、お客様のライフサイクルにわたって満足度の高いトータルソリューションを提供するため、営業とSEの一体化、グループのフォーメーション革新など、効率的な仕組みの整備に取り組んできました。

これに基づき、2006年3月期より、現在のセグメント区分を、当社のお客様を主体に見た製品区分に見直します。まず、テクノロジーソリューションは、お客様の求める高性能・高品質のプロダクトとソフトウェア・サービスのトータルソリューションを提供する富士通グループの中心ドメインと位置付け、利益と成長を追求していきます。

次に、ユビキタスプロダクト・ソリューションは、パソコンや携帯電話、ハードディスクビジネスといった、これからのユビキタス社会で個人のニーズにより密接した製品を取り扱う分野として、スピードと品質そして原価低減を追求していきます。

さらに、デバイスソリューションでは、一連の事業構造改革やアライアンスにより経営資源を最先端のロジックLSIに集中し、関連する部品ビジネスとともに他社に真似のできない先端技術と品質そして効率性を追求していきます。



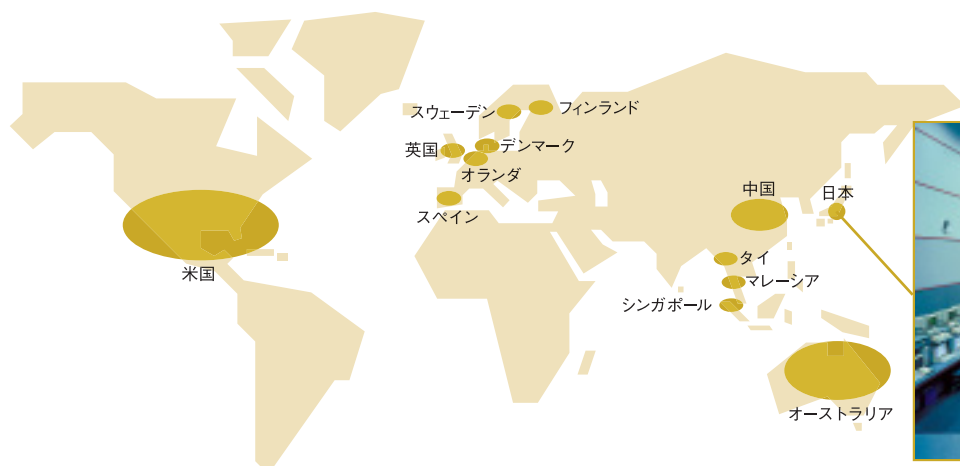
*小型磁気ディスク装置

■ ソフトウェア・サービス

■ 市場環境と業績

IT投資については、国内では、金融機関のセキュリティ強化、流通・運輸業界でのトレーサビリティ導入など次世代システム開発の動きが出始めているものの、全体としては業種・規模・地域など、個別の企業レベルにおいて投資意欲は異なり、力強さに欠けた状況が続いています。一方、海外では欧州を中心にアウトソーシングビジネスが活発化しており、今後も拡大が見込まれます。

こうした環境の中、総合システム開発体系「SDAS^{*1}」の積極的な導入や、スピード経営を支えるIT基盤「TRIOLE^{*2}」を駆使した差別化戦略を展開しましたが、国内においては、再三にわたる不採算プロジェクトの拡大などにより、ソリューション／SIの伸び悩みが目立ちました。海外においては、欧米を中心としたグローバルなビジネスを積極的に展開しました。これらの結果、ソフトウェア・サービスの売上高は2兆704億円となりました。当該売上高は前期比で1.1%減少していますが、前期に実施した北米事業の再編による影響を除いた継続事業ベースで見ると前期並みの水準を維持しています。営業利益においては、英国の富士通サービス社による政府系大型アウトソーシングなど大型商談獲得による増収効果や米国の富士通



アジア、アメリカ、ヨーロッパを中心に、世界各国に展開する「富士通グローバルシステムセンター」



国内最大規模の「館林システムセンター」

コンサルティング社の事業構造改革効果など海外部門での好調な要因はあったものの、国内の不採算プロジェクトの開発コスト拡大などをカバーしきれず、前期比大幅減の1,130億円となりました。

■ 実施策

収益性改善の施策としては、まず当期において損失が拡大した不採算プロジェクトに対する取り組みの強化があげられます。具体的には、2004年2月にプロジェクト進行の各段階で審査を行う組織を新設し、プロジェクトのリスクマネジメント強化と契約面の見直しなどを進めてきました。また「フォーメーションの革新」の一環として、2004年6月に組織再編を行いました。ソリューションビジネスにおける営業とSEを顧客ごとに一体化し、顧客の経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築しました。さらに、2005年4月には社長直轄の「SIアシュアランス本部」を設立し、不採算プロジェクトの新規発生防止体制をより強化しました。こうした取り組みが奏効し、不採算プロジェクトの新規発生は劇的に減少しています。

このほか2004年10月には、顧客のITライフサイクルマ

ネジメント全般にわたるサポートの充実を図るため、富士通サポートアンドサービス(株)を当社の完全子会社としました。

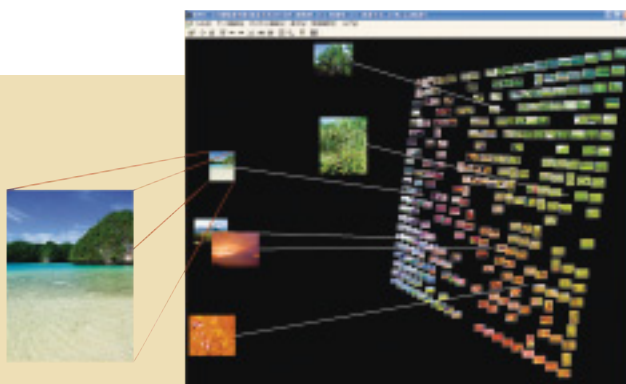
■ 今後の課題

さらなる開発期間の短縮と開発効率の改善を図るために、今後は「SDAS」の適用を新規プロジェクトに拡大させていく予定です。また「TRIOLE」の展開を引き続き推進するほか、今後国内・海外とも成長が見込まれるアウトソーシングビジネスの一層の拡大を図ります。

プロジェクト管理については、ソフトウェアの開発請負契約についての進行基準を2005年度受注分から全面適用しており、これによってリアルタイムのプロジェクト管理を実現し、プロジェクトの可視化を進めます。また、SIアシュアランス本部の機能を積極的に活用することで、プロジェクトの採算性改善に全力を注ぎます。

*1 SDAS: Systems Development Architecture & Support facilities
当社お客様のアプリケーション開発における生産性向上を実現するための開発体系

*2 TRIOLE: 社会・企業に要求される「ビジネスの成長・拡大」「スピーディーな業務構築」「システムの安定稼働とTCO削減」を実現する富士通のIT基盤



画像を眺めて欲しい情報を選べる検索ソフトウェア
MultimediaArchiveExplorer



将来のユビキタス社会の一端を、IT利活用シーンを通じてわかりやすく紹介する「netCommunity」(東京都千代田区)

■ プラットフォーム

■ 市場環境と業績

サーバ市場は、国内では力強さに欠けた状況が続いているものの、海外では景況感の回復に合わせ堅調に推移しました。モバイルシステム市場では、国内の第3世代移動通信(3G)サービスの伸展に伴い、3Gビジネス*1が拡大しました。またキャリア／企業ネットワークのIP化も世界規模で本格化しており、光システムビジネスも拡大しました。

こうした中、プラットフォーム事業の売上高は、欧州や北米など海外を主体にUNIXサーバが好調に推移したことなどにより前期比6.0%増加の1兆7,051億円、営業利益については、前期比257億円増の550億円となりました。

■ 実施策／製品・サービス

2004年6月に、世界で初めて90nm半導体技術を採用した64ビットプロセッサ搭載のUNIXサーバを発売しました。また、2004年12月には浜松町(東京都港区)に、お客様が効率的にシステム性能や品質などを検証することができるプラットフォームソリューションセンターを開設しました。

サーバ関連ではさらに2005年4月、メインフレームクラスの高い信頼性と性能を備えた新基幹IAサーバ「PRIMEQUEST」を世界同時発売しています。



PRIMEQUEST
左:システムボード(CPU／メモリ搭載用ユニット)、右:専用チップセット(CPU制御用)

このほか、当社の高い技術力を活かした世界初の「手のひら静脈認証」技術は、個人情報の保護や偽造カード対応といったセキュリティ関連システムの需要の高まりを背景に複数の金融機関のATMなどで採用されました。

海外では、北米の2大通信キャリアであるSBC社、ベライゾン社のほか、大規模なCATV網を有するコムキャスト社向けに光システムを積極的に販売し、SONET (Synchronous Optical Network) 部門でトップシェアを堅持することができました。英国では、ブリティッシュテレコム (BT) 社との強力なパートナーシップによりADSLシステムでトップシェアを獲得しており、今までの実績が評価され、BT社の21st Century Networkの推奨サプライヤーとして選定されました。

このほか当期は有力なパートナーとの提携を進めました。具体的には、サン・マイクロシステムズ社とのUNIXサーバ分野での共同開発・提供、マイクロソフト社やレッドハット社との次世代基幹IAサーバ開発についての協業、シスコシステムズ社とのルータ・スイッチ分野での戦略提携のほか、HDDヘッドの製造にかかるTDK(株)との合弁会社設立などがあげられます。

■ 今後の課題

顧客の業務処理を担う起点としてのサーバビジネスをグローバルに展開することで、関連プロダクトやサービスへの波及効果を狙います。この一環として、新基幹IAサーバ「PRIMEQUEST」を拡販していきます。

また、シスコシステムズ社との提携によるキャリア向け・企業向けIPソリューションの拡充のほか、ITと通信を統合したソリューションの提供により、IPネットワークビジネスの拡大を図ります。

3Gモバイルシステムビジネスでは、堅調な国内3Gビジネスに注力するとともに、アルカテル社と協調して、世界シェアを高めます。北米・欧州においては、現状のお客様との良好な関係をてこにして、ブロードバンド化・IP化に対応した強い光システムを展開し、さらなるビジネス拡大を目指します。また、本格化する光アクセスに注力するとともに、WiMAX^{*2}などの多様化するブロードバンド・ワイヤレスアクセスにも積極的に対応し、新たなビジネスを開拓します。

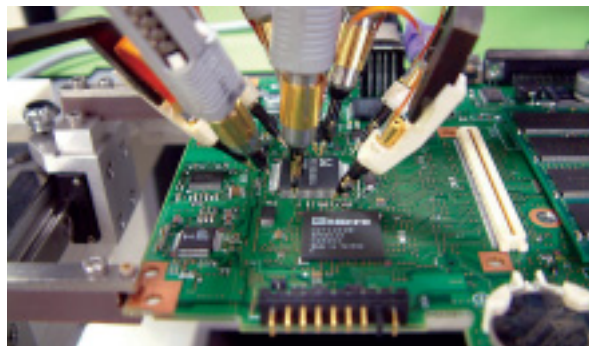
パソコンについては、コンシューマー向けはAV機能を、企業向けはセキュリティ機能を強化します。携帯電話はさらなる生産性の向上やコストダウンの推進を図ります。HDDについては品質面のさらなる向上を図ります。

^{*1} 3Gビジネス: 第3世代 (3G) 移動通信対応の携帯電話通信システム

^{*2} WiMAX: Wi-FiやBluetoothなどの規格よりも広範囲な、数マイル規模のカバーエリアをもった無線通信規格



プラットフォームソリューションセンター サーバルーム (東京都港区)



独自開発装置によるFMV-LIFEBOOKメインボードの高品質設計 (島根富士通)

■ 電子デバイス

■ 市場環境と業績

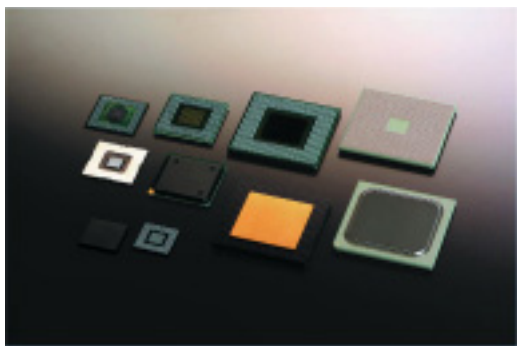
当期の市場環境は、上期においてはプラズマテレビや液晶テレビ、またDVDレコーダーなどのデジタル家電が好調に推移しましたが、下期に入るとこれらの製品の需要の鈍化が見られ、電子部品市況も急速に悪化しました。

こうした業界全体の動きを受けて、当期の電子デバイス事業は、プラズマディスプレイ (PDP)、液晶ディスプレイ (LCD) が価格競争激化により減収となったものの、その他のデジタル家電、車載向けLSIの増収、電子部品系子会社の好調な売上が業績に寄与しました。

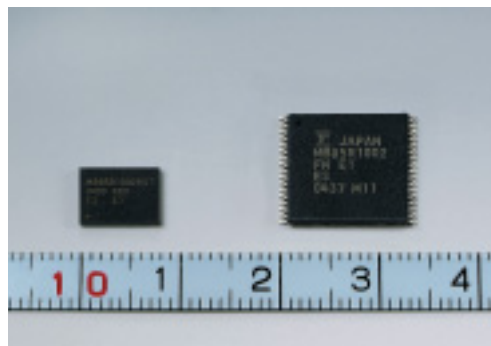
これらにより、当期における電子デバイスの売上高は7,338億円となりました。当該売上高は前期比で0.1%の減少ですが、化合物半導体事業、フラッシュメモリ製造子会社の持分法への移行による影響を除いた継続事業ベースで見ると、前期比4.6%の増収となりました。営業利益については、PDP、LCDが悪化したものの、ロジック事業の増収効果、システムメモリ事業の収益改善により半導体で大幅な増益となり、営業利益は325億円と前年比50億円の増益となりました。

■ 実施策／製品・サービス

当期においては、先端90nmテクノロジーを使用した商品 (COT、ASICなど)、世界最大容量となる1メガビット



ASIC



世界最大容量、1メガビットFRAM

FRAM^{*1}や、世界最小の携帯電話向け北米PCS方式対応SAWデュプレクサなど、様々な種類の高付加価値デバイスを市場に投入しました。また当社グループでは、2002年から実施している事業構造改革の一環として、最も競争優位性が高い分野であるLSI事業への資源集中を進めており、改革は着実に進捗しています。当期はデジタル家電、携帯電話、パソコン／パソコン周辺機、サーバ／ネットワーク分野をターゲットに、先端事業(90nm)と基盤事業(～130nm)のポートフォリオバランスを重視し、先端・基盤事業の両輪での利益拡大に注力しました。先端商品では、他社を凌駕する90nmテクノロジーを武器に最先端商品からファウンドリーまでの多様なソリューション提供によってお客様とのパートナーシップ強化を進め、事業拡大の足がかりとして、20社を超えるビジネス獲得に成功しました。基盤事業では、トヨタ生産方式の展開拡大によって生産性の向上を図り、競争力の強化・利益拡大を追求し収益性の継続的確保を図りました。

当社グループがLSI事業に経営資源を集中する背景には、組み込みソフトウェアの開発力、設計手法、解析・検証力、先端プロセステクノロジーといった分野において、世界トップクラスの技術力の存在があります。

次世代LSIの量産を視野に入れた半導体製造能力の拡充計画も順調に進んでいます。三重工場に新棟として構

築した90nm／65nmに対応した300mm大口径ウェーハ採用のロジックLSI量産工場は、2004年4月の着工から2005年2月のパイロット試験終了まで世界最速で立ち上げを完了しました。同年4月からは正式稼働を開始しており、9月の量産開始に向けた準備が着々と進んでいます。

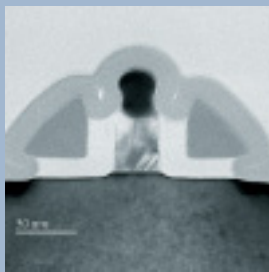
また、LSI事業への資源集中を図る目的から、2005年3月にはPDP事業の当社持分の大半を(株)日立製作所に譲渡したほか、6月にはLCD事業をシャープ(株)に譲渡しました。

■ 今後の課題

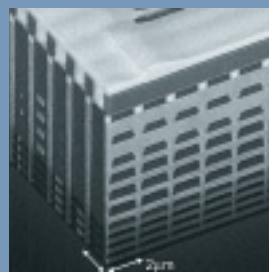
今後の取り組みとしては、差別化技術であるLow Power技術、『一発完動』^{*2}の設計技術をベースに、社内及び社外パートナーとの連携、お客様との源流からの戦略的パートナーシップをさらに強化し、お客様とともに当社の保有する技術力とあいまって商品競争力を実現する「New IDM」ビジネスのさらなる強化を実施します。また、今後予想される価格競争の激化など、厳しい市場環境にも耐えうる強い事業体を目指し、設計能力の拡充、テクノロジー開発の継続的な生産革新の取り組み強化によるコストダウン、生産性のアップによる原価低減を強化していきます。

^{*1} FRAM: Ferroelectric Random Access Memory
高速な読み出しや書き込みが可能な不揮発性メモリ

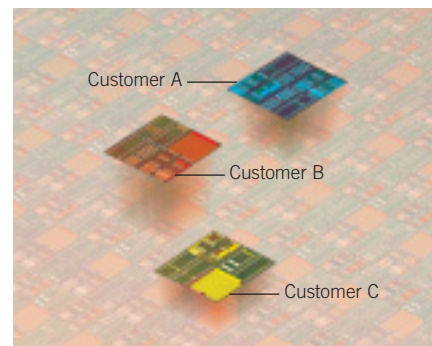
^{*2} 一回の設計で、LSIの機能がすべて動作すること



90nmトランジスタ拡大図



LSIに用いられている最先端多層配線



SiExpress™のイメージ: 1枚のマスク内に複数のICを搭載して、同一ウェーハ上に複数のICを製造する方法